

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(电话会议)
参与单位名称及人员姓名	长城基金管理有限公司（周诗博、付晓钦）、金信基金管理有限公司（黄逸凡）、深圳前海海雅金融控股有限公司（邓东升）、上海水璞私募基金管理中心（有限合伙）（郁凯伦）、中信证券股份有限公司（李焕忠）、中泰证券股份有限公司（张晨飞）、德邦证券股份有限公司（田思聪）等（排名不分先后）
时间	2023年11月30日（星期四）下午 14:00 至 15:30
地点	劲拓光电产业园会议室、部分生产车间
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 陈文娟女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、接待人员介绍公司基本情况</p> <p style="text-align: center;">（一）公司简介</p> <p>劲拓股份（300400）是一家深圳证券交易所创业板上市公司，成立于2004年，2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园，目前同步使用中，建筑面积合计约10万平方米，本次活动所在位置是宝安石岩的劲拓光电产业园。</p> <p style="text-align: center;">（二）公司从事的主要业务</p> <p>公司主营专用设备业务，具体可分为三类：电子装联设备（电子热工设备及配套设备）、半导体专用设备、光电显示设备。</p> <p>1、公司设立以来持续深耕电子热工领域，被行业协会授予“电子热工领域龙头企业”称号，回流焊设备获国家工信部“制造业单项冠军产品”认证、全球市场占有率领先。此项业务系公司领先优势业务，也是公司的基本盘。</p> <p>2、公司2022年起规模化销售半导体专用设备，目前系公司集中资源发展的战略级业务。半导体专用设备实现关键技术突破，研制生产了半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无尘压力烤箱等多款半导体热工设备，并具备为客户提供不同制造工艺设备的定制能力；产品累计交付服务客户超过20家，获得客户的认</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>可、验收及复购。</p> <p>3、公司主营产品还包含光电显示设备，应用领域覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片等的制程，产品突破海外技术封锁，得到京东方等国产面板厂商和大型模组厂的认可并实现长期深度合作。</p> <p>（三）公司的经营情况</p> <p>2023 年前三季度，公司实现营业总收入 55,679.04 万元，较上年同期增长 0.41%；归属于上市公司股东的净利润 3,856.91 万元，经营活动产生的现金流量净额 6,328.84 万元。公司 2023 年前三季度具体经营情况，可参见披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》《2023 年三季度报告》。</p> <p>二、问答交流</p> <p>1、公司半导体专用设备有哪些？应用领域有哪些？</p> <p>回复：公司半导体专用设备目前主要为应用于芯片制程后道工艺的封装热处理设备，包含半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、真空甲酸焊接设备、甩胶机、氮气烤箱、无尘压力烤箱等，广泛应用于各类芯片元器件的封装过程及先进封装工艺，产品具体情况可以参见公司《2023 年半年度报告》。公司半导体专用设备目前主要面向国内封测厂商，累计服务客户逾 20 家，其中包含优质的上市公司、大型企业。</p> <p>2、公司半导体专用设备 2024 年业绩预期如何？</p> <p>回复：公司半导体专用设备目前以用于芯片的先进封装制造等生产环节的热处理设备为主，其在技术和性能方面对标美国等国的一些技术和产品成熟度较高的企业，同时具备价格、交期、售后服务等方面的优势，具有较强的进口替代实力。</p> <p>公司将继续把握相关设备国产化的产业机遇，面向下游封测厂商持续开展客户拓展、推进产品验证，在持续推动产品在 IGBT、IC 载板、WaferBumping、ClipBonding、FCBGA 等生产制造领域应用并拓展应用范围的同时、有重点地积累细分市场客户群体，持续升级性能配置、满足不同客户和不同应用需求，夯实核心竞争力、促进收入稳健爬坡。</p> <p>3、电子装联设备有哪些主要客户？</p> <p>回复：公司电子装联设备用于组建电子工业中的 PCBA 生产线，应用范围较为广泛，不仅包含通讯电子和消费电子，还有白色家电、汽车电子、航空航天电子等领域。公司电子装联设备的主要客户包含上述领域优质上市公司、大型企业等。</p>
----------------------	---

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>4、电子装联业务 2024 年业绩预期如何？</p> <p>回复：广泛的消费电子行业除智能手机、PC 等，还包含汽车电子、智能家居等领域，近年来以智能手机为主的消费电子行业经历了一轮下行周期后，逐渐呈现企稳态势；而汽车电子等领域受到新能源汽车市场需求旺盛等因素影响，市场景气度相对好；泛消费电子行业呈现结构性行情，而大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G 通信等新兴技术的应用，对于新型硬件需求产生刺激作用。行业需求回暖、固定资产投资复苏，预计长期将对公司电子装联业务的市场拓展和产品销售有积极影响。</p> <p>公司电子热工设备产品和技术成熟度较高，处于行业领先地位。随着有关应用领域对工艺和技术要求升级，设备向智能化、灵活化、环保化，以及更高精度、高速度、多功能方向发展，还需要具备非标准化设备服务能力。公司将继续通过研发创新、产品升级筑牢业务发展根基、深挖护城河，不断推动电子整机装联业务持续高质量发展。</p> <p>5、公司光电显示设备后续前景展望如何？</p> <p>回复：公司光电显示设备用于光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组的生产制造过程，按功能分类主要有 3D 贴合设备、生物识别模组生产设备、LCM 焊接类设备、贴附机等，相关产品已经覆盖 AMOLED 柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域。</p> <p>电子产品终端市场需求回暖有望拉动上游显示模组需求增长，对公司光电显示设备的市场拓展和产品销售有积极影响。公司将继续保持与核心客户的合作粘性，争取深化核心客户合作、扩大对核心客户销售规模、增厚经营业绩。</p> <p>6、公司专用设备的价格是多少？</p> <p>回复：公司专用设备分为电子装联设备、半导体专用设备、光电显示设备，根据不同设备用途、配置要求，以及定制化、智能化程度不同，价格会有一定的差异。</p> <p>7、公司今年前三季度产品毛利率情况如何？是否针对进一步提升毛利率采取措施？</p> <p>回复：公司产品综合毛利率随着各期收入结构变动可能会有小幅波动，大致情况可参见《2023 年半年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”“三、主营业务分析”的相关内容。</p>
----------------------	---

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>公司始终注重产品和技术创新，以提升产品性能和竞争力为重点，同时抓牢核心优质客户，并通过采购端实施供应链管控、生产端落实科学排产和精益生产等多种措施合理控制成本，保持并力争增强主营业务的盈利能力。</p> <p>8、公司今年前三季度业绩的具体情况如何？研发费用增长原因是什么？</p> <p>回复：公司 2023 年三季度主要受到市场环境等因素影响，短期收入承压、业绩波动；同时由于研发投入和营销力度加大等原因，致使相关费用增加，对净利润有所影响。</p> <p>公司当前主营业务经营情况稳健，未来将继续立足于电子装联业务基本盘，梳理和整合内外部资源、推动战略级业务半导体专用设备业务发展，力争把握产业趋势和结构性机会扩大收入规模、增厚业绩；同时继续落实资源利用、降本增效、精益生产和供应链管理系列措施，开源节流、提升盈利水平。公司各期经营业绩具体情况，敬请以公司披露于巨潮资讯网的定期报告、相关临时公告为准。</p> <p>研发方面，公司今年持续在半导体专用设备等业务领域进行产品和技术研发，针对已有产品线进行升级、提高智能化和数字化水平、优化应用操作体验等。公司后续将继续攻关芯片封测等环节一些有技术壁垒且国产空白的半导体专用设备，推动半导体专用设备产品拓展、性能提升、研发成果转化；同时汲取不同场景的应用经验，优化和提升电子装联设备、光电显示设备性能，提高产品技术壁垒。</p> <p>三、现场参观</p> <p>现场交流结束后，调研人员有序参观了公司部分电子装联设备、半导体专用设备及光电显示设备生产车间，接待人员详细介绍了公司产品的具体情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 11 月 30 日</p>